

■ 財務概況

財務概況

損益状況

当期の事業環境

2013年3月期は、欧州債務問題の長期化、米国の財政問題等による先行き不安および中国をはじめとする新興国の成長率鈍化により世界的に景気不安感が広がりましたが、年度末には景気は緩やかな回復の動きをみせました。また、日本経済においても、年度末にかけて円高是正が急速に進みましたが、長期にわたる円高の影響や世界経済の減速懸念を背景に、年間を通してみれば景気は総じて低調に推移し、回復は緩やかなものに留まりました。

当社の参画するエレクトロニクス産業においては、スマートフォンの普及が本格化し市場の牽引役となったものの、パソコンやテレビ等の販売不振により半導体メモリおよび液晶パネルの需給バランスが悪化し、当社の顧客である半導体メーカーおよびFPD(フラットパネルディスプレイ)メーカーの設備投資が抑制されました。

当期の企業買収

2013年3月期、NEXX Systems, Inc.(現TEL NEXX, Inc.)、FSI International, Inc.(現TEL FSI, Inc.)、Oerlikon Solar Holding AG(現TEL Solar Holding AG)、Magnetic Solutions Ltd.(現TEL Magnetic Solutions Ltd.)の計4社の買収を行いました。

TEL Solar Holding AGについては、貸借対照表のみが当期から連結され、貸借対照表以外の計算書の連結は2014年3月期からになります。

なお、TEL Solar Holding AGを除く3社については、いずれの買収も当期業績に与える影響は軽微でした。

買収に関する補足情報については、連結財務諸表注記20.企業結合(P31～33)をご参照ください。

売上の状況

事業環境低迷の影響を受け、主力である半導体製造装置およびFPD製造装置の売上が大きく減少したために、当期の売上高は前期比21.4%減少の4,973億円となりました。

国内売上高は前期比30.8%減少の1,185億円、海外売上高は18.0%減少の3,788億円となり、連結売上高に占める海外売上高の比率は前期の72.9%から76.2%へと3.3ポイント上昇しました。

なお、当期の受注高は前期比16.7%減少の4,506億円、当期末の受注残高は16.5%減少の1,808億円となりました。

売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益(損失)

売上原価は前期比19.7%減少の3,385億円となりましたが、売上高の減少率が上回ったため、売上原価率は前期から1.5ポイント悪化の68.1%となりました。

これにより、売上総利益は24.9%減少の1,588億円となり、売上総利益率は前期の33.4%から31.9%に低下しました。

販売費及び一般管理費は、前期比3.2%減少の1,462億円となりましたが、連結売上高に対する比率は前期の23.9%から29.4%に上昇しました。

なお、当期、全社ベースで約160億円に上る固定費削減策を実行し、収益性の改善に努めました。

これらの結果、営業利益は前期比79.2%減少の125億円、営業利益率は前期の9.5%から2.5%に低下しました。

研究開発費

研究開発費は、前期比10.1%減少の732億円となりました。前期に比べて減少しましたが、技術開発が当社の成長の源泉であるとの考えは変わらず、既存分野の強化のみならず、今後の成長が見込まれる新規分野に当期も積極的な投資を行いました。対売上高比率は前期の12.9%から14.7%に上昇しました。

半導体製造装置分野では、多様化する技術に対応すべく、各製品カテゴリにおいて新製品開発の強化に努めました。3次元構造デバイス等の次世代デバイスに要求されるプロセス技術・装置開発をはじめ、先端パッケージング技術、さらには省エネルギー化の要求に対応するための省電力化技術等、環境に配慮した技術開発にも注力しました。また、次世代メモリの製造技術、将来のウェーハの大口径化(450mmウェーハ)のための装置開発等にも着手しています。

FPD/PV製造装置分野では、有機ELディスプレイ製造装置の開発、薄膜シリコン太陽光パネル製造装置のさらなる変換効率向上を目指した装置開発を行いました。

また、基礎・要素研究関連では、さらなる微細化のための新プロセス技術や新材料に対応するプロセス技術など、他社との差別化を図るための各種コア技術の開発に注力しました。

その他収益(費用)および当期純利益

当期は、主な収益として受取利息及び受取配当金17億円、補助金収入27億円を、また主な費用として純額で為替差損15億円を計上しました。その結果、その他収益(費用)は純額で52億円の収益となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益は70.7%減少の178億円、当期純利益は83.5%減少の61億円を計上することとなりました。1株当たり当期純利益は前期の205.04円から33.91円となりました。

包括利益

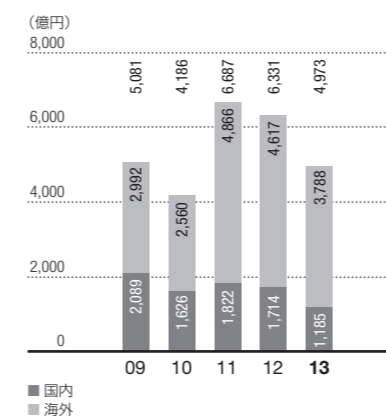
当期は、期末にかけて急速に進んだ円安の影響により為替換算調整勘定として88億円の利益を計上しましたが、当期純利益が前期から大きく減少したため、包括利益は前期比57.2%減少の158億円となりました。

配当政策および当期配当金

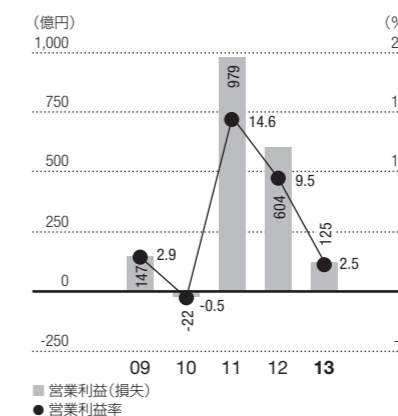
当社は、業績連動型・収益対応型の配当を株主還元の基本方針とし、連結当期純利益に対する配当性向35%を目途とする配当を実施しています。当期は、当社の創立50年目にあたることから記念配当20円を加え、通期の1株当たり配当金は51円(配当性向150.4%)となりました。

損益状況	百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
売上高	¥508,082	¥418,637	¥668,722	¥633,091	¥497,300
売上総利益	137,408	108,316	234,758	211,445	158,755
売上総利益率	27.0%	25.9%	35.1%	33.4%	31.9%
販売費及び一般管理費	122,697	110,497	136,888	151,002	146,206
営業利益(損失)	14,711	(2,181)	97,870	60,443	12,549
営業利益率	2.9%	(0.5)%	14.6%	9.5%	2.5%
税金等調整前当期純利益(損失)	9,637	(7,768)	99,579	60,602	17,767
当期純利益(損失)	7,543	(9,033)	71,924	36,726	6,076

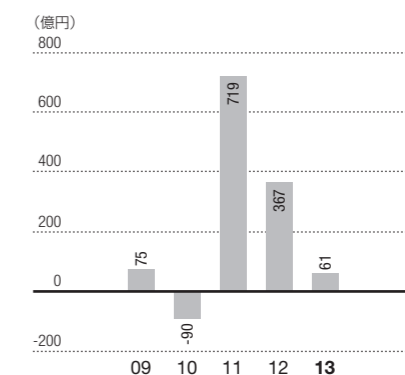
国内および海外売上高



営業利益(損失)および営業利益率



当期純利益(損失)



■ 財務概況

財務概況

セグメント別の状況

■ 半導体製造装置

スマートフォン、タブレット等の先端モバイル機器に牽引され、ロジック向け半導体設備投資は比較的堅調でしたが、パソコン出荷の低迷等を背景に、メモリ向け半導体設備投資が低調であった前期からさらに縮小しました。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は18.0%減少の3,920億円となりました。セグメント間の内部売上高又は振替高を含む当セグメントの売上高は、前期比18.0%減少の3,921億円、セグメント利益は前期比45.4%減少の486億円、セグメント利益率は前期の18.6%から12.4%に低下しました。

当期の受注高は前期比21.7%減少の3,425億円、期末の受注残高は前期比24.9%減少の1,416億円となりました。

当部門の営業概況については、P13をご参照ください。

■ FPD/PV(フラットパネルディスプレイおよび太陽光パネル)製造装置

モバイル機器向けの中小型パネル用設備投資は堅調でしたが、薄型テレビ需要が先進国で一巡したことを背景に大型パネル用設備投資が先送りされ、FPD製造装置市場が大幅に縮小しました。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比71.2%減少の202億円となりました。また、セグメント間の内部売上高又は振替高を含む当セグメントの売上高も前期比71.2%減少の202億円、セグメント利益は前期の23億円の利益計上から64億円の損失計上となりました。なお、FPD製造装置売上が当セグメント売上のほぼ100%を占めました。

当期の受注高は前期比18.1%増加の220億円、期末の受注残高は前期比72.0%増加の244億円となりました。

当部門の営業概況については、P13をご参照ください。

■ 電子部品・情報通信機器

国内電子部品市場は、民生用電子機器・産業機器向けともに低水準でしたが、データセンターなどのクラウドコンピューティング市場は拡大基調にありました。

当セグメントの外部顧客に対する売上高は前期比0.2%減少の847億円となりました。セグメント間の内部売上高又は振替高を含むセグメント売上高は、前期比1.0%減少の855億円、セグメント利益は前期比44.5%減少の13億円、セグメント利益率は前期の2.7%から1.5%に低下しました。

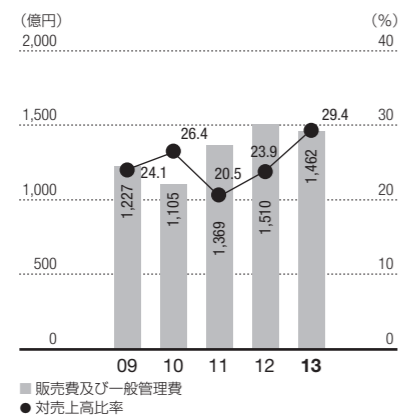
当部門の営業概況については、P13をご参照ください。

■ その他

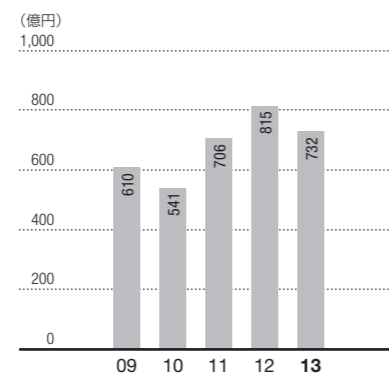
その他の売上は、当社グループの物流、施設管理および保険業務等の内部サービス関連業務の売上です。なお、当部門の外部顧客に対する売上高は4億円となり、前期とほとんど変化はありませんでした。

セグメント情報	報告セグメント				合計	調整額	連結財務諸表計上額
	半導体製造装置	FPD/PV製造装置	電子部品・情報通信機器	その他			
2013:							
売上高							
外部顧客への売上高	¥392,027	¥20,160	¥84,665	¥ 448	¥497,300	¥ —	¥497,300
セグメント間の内部売上高又は振替高	43	—	813	10,613	11,469	(11,469)	—
計	392,070	20,160	85,478	11,061	508,769	(11,469)	497,300
セグメント利益(損失)	48,600	(6,355)	1,283	1,321	44,849	(27,082)	17,767
セグメント資産	223,956	49,489	47,557	1,550	322,552	452,976	775,528
減価償却費	12,330	462	448	78	13,318	13,313	26,631
のれんの償却額	1,038	—	103	—	1,141	—	1,141
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	13,464	1,661	482	54	15,661	9,834	25,495

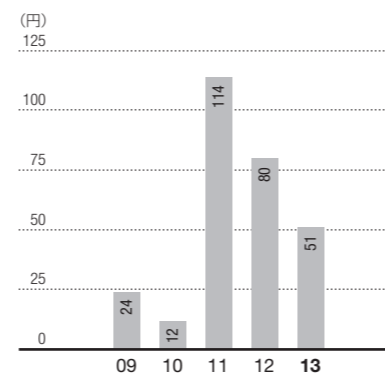
販売費及び一般管理費および対売上高比率



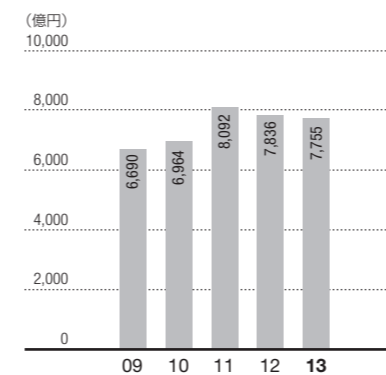
研究開発費



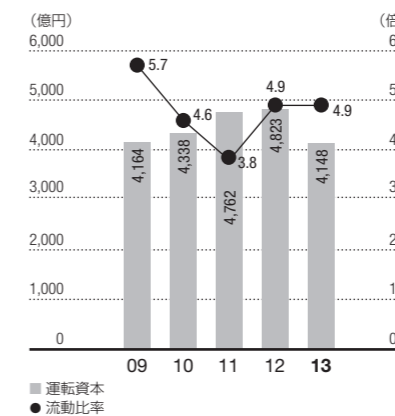
1株当たり配当金



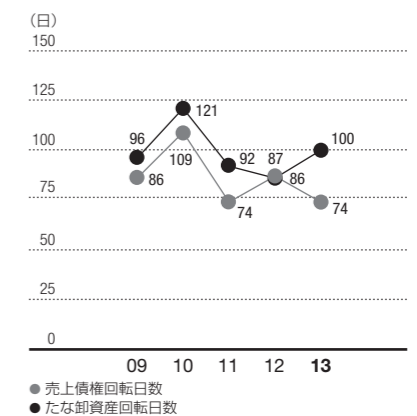
総資産



運転資本および流動比率



売上債権回転日数およびたな卸資産回転日数



■ 財務概況

財務概況

財政状態およびキャッシュ・フロー

資産、負債及び純資産

■ 資産

流動資産は、前期末に比べ855億円減少し、5,215億円となりました。主な内容は、受取手形及び売掛金の減少498億円、たな卸資産の減少138億円、手元流動性(現金及び現金同等物に短期投資を加えたもの)の減少75億円によるものです。なお、売上債権回転日数は前期の87日から74日に改善、たな卸資産回転日数は前期の86日から100日に悪化しました。

有形固定資産は、新規取得分が218億円ありましたが、減価償却実施額266億円等を差し引き、純額で88億円増加の1,357億円となりました。

投資その他の資産は、前期末から687億円増加し、1,183億円となりました。海外4社の企業買収によるのれんの増加384億円および無形固定資産の増加168億円が主な増加の要因です。これらの結果、総資産は、前期末から81億円減少し、7,755億円となりました。

■ 負債及び純資産

流動負債は、前期末に比べ181億円減少し1,067億円となりました。主な減少要因は、支払手形及び買掛金の減少107億円、前受金の減少74億円です。有利子負債は前期の44億円から38億円に減少し、デット・エクイティ・レシオ(有利子負債/自己資本)は前期末比0.2ポイント低下の0.6%となりました。

長期負債は、退職給付引当金の20億円の増加を主要因に前期末比35億円増加し637億円となりましたが、流動負債と長期負債を合わせた負債合計は、前期末に比べ146億円減少して1,704億円となりました。

純資産は、前期末に比べ65億円増加し6,051億円となりました。主として、当期純利益61億円の計上および配当金93億円の支払いによる利益剰余金33億円の減少、円安による為替換算調整勘定の87億円の増加によるものです。この結果、自己資本比率は前期の74.9%から1.6ポイント上昇し、76.5%となりました。一方、自己資本当期純利益率(ROE)は前期の6.3%から1.0%に低下しました。

設備投資額*1および減価償却費*2

当期の設備投資額は、複数の開発製造拠点が設立された前期と比較して44.9%減少の218億円となりました。

当期は、半導体製造装置事業およびFPD/PV製造装置事業において、高成長が期待できる分野を中心に評価用機械装置等の取得を行いました。また、当期より新研究開発拠点として稼働を開始したつくば市のテクノロジーセンターおよび韓国ファソン市のプロセス開発センターにて使用する開発・評価用機械装置の購入にも資金を投じました。

減価償却費は10.1%増加の266億円でした。

*1 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています。
*2 減価償却費にはのれん償却額および減損損失は含まれていません。

キャッシュ・フロー

営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期比546億円増加の843億円となりました。主な内容として、税金等調整前当期純利益178億円、売上債権の減少575億円、減価償却費266億円、たな卸資産の減少203億円がそれぞれキャッシュ・フローの増加要因に、仕入債務の減少155億円、前受金の減少125億円が減少要因となりました。

投資活動により支出したキャッシュ・フローは、前期の84億円から1,418億円となりました。定期預金および短期投資の純増による支出661億円、有形固定資産の取得による支出190億円に加え、企業買収(現金を対価とする株式の取得)4件に551億円支出したために、大幅な増加となりました。

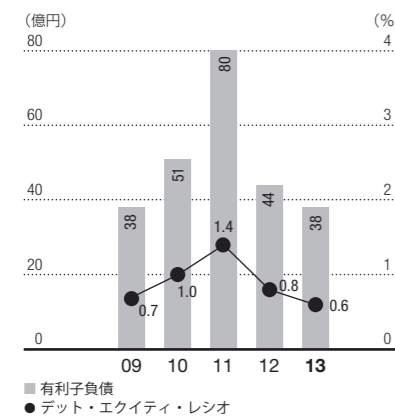
財務活動により支出したキャッシュ・フローは、主に配当金の支払い93億円により、前期の273億円に対し106億円となりました。

現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ735億円減少し、853億円となりました。なお、現金及び現金同等物に短期投資を加えた残高(手元流動性)は、前期末に比べ75億円減少し、2,401億円となりました。

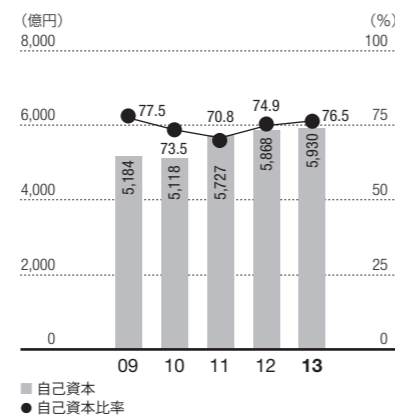
財政状態	百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
流動資産	¥505,687	¥552,939	¥644,231	¥607,051	¥521,501
有形固定資産	99,906	92,128	112,552	126,885	135,698
投資その他資産	63,405	51,285	52,422	49,675	118,329
総資産	668,998	696,352	809,205	783,611	775,528
流動負債	89,272	119,162	168,038	124,794	106,670
負債合計	139,733	172,982	224,403	185,008	170,401
純資産	529,265	523,370	584,802	598,603	605,127

キャッシュ・フロー	百万円				
	2009	2010	2011	2012	2013
営業活動によるキャッシュ・フロー	¥ 81,030	¥ 48,285	¥ 83,239	¥ 29,712	¥ 84,267
投資活動によるキャッシュ・フロー	(160,622)	9,613	(35,882)	(8,352)	(141,769)
財務活動によるキャッシュ・フロー	(46,016)	(288)	(5,237)	(27,335)	(10,625)
現金及び現金同等物期末残高	65,883	123,940	165,051	158,776	85,314

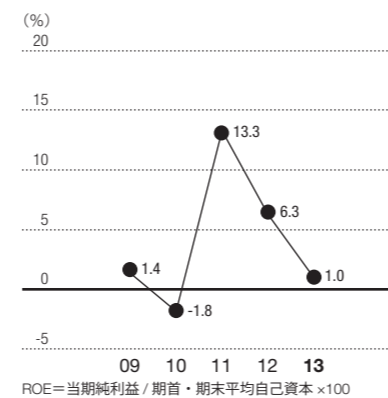
有利子負債および
デット・エクイティ・レシオ



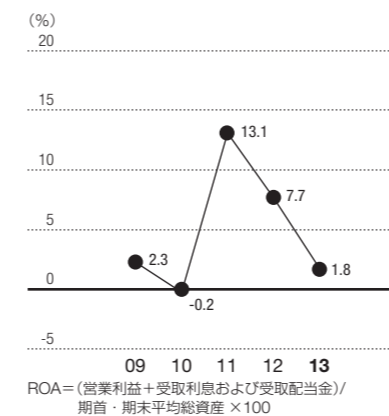
自己資本および自己資本比率



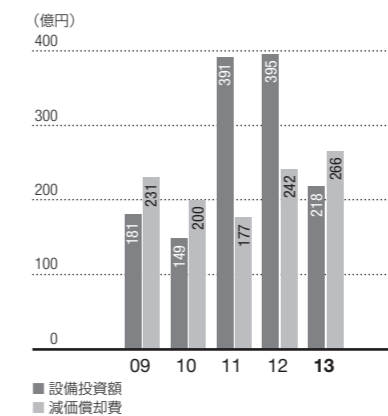
ROE



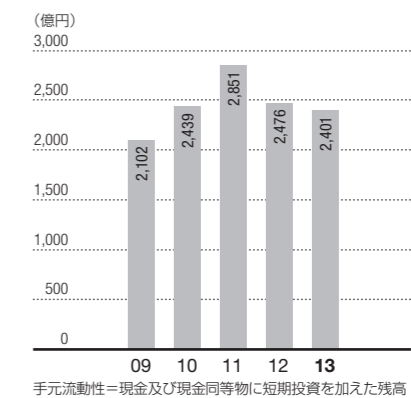
ROA



設備投資額および減価償却費



手元流動性



■ 財務概況

財務概況

事業等のリスク

当社の経営成績、財務状況及び当社株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1)半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置等のハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加、顧客の財務状況悪化による貸倒損失、仕入先の経営状態悪化による供給不足等が発生する場合には、当社業績に少なからず悪影響を及ぼす可能性があります。

(2)特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品及び顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3)研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術等の最先端技術について積極的な研究開発投資及び研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれ等の影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4)安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理等の各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しております。しかしながら、当社製品に関連する安全性等の問題により、顧客への損害発生、受注取消等が発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5)品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、及びレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用していただくことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品である等の原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品が発生する等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6)知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略及び知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や特許その他の知的財産権を使用する上で制約される場合等があるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7)外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっております。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としておりますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約等によって為替リスクヘッジに努めております。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8)企業買収による影響

当社は、事業戦略の一環として、新たな事業領域への進出、新技術・ビジネス基盤の獲得、既存事業の競争力強化などを目的とした企業買収を実施することがあります。具体的な実施にあたっては入念な調査・検討を行っております。しかしながら、買収後に当初期待した成果が十分に得られなかった場合には、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9)その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業における更なる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社及び他業種企業と同様に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力、金融・株式市場、政府等による規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失等の影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。